

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO

CONSULTA PÚBLICA Nº 13, DE 28 DE MAIO DE 2013

A Secretária do Desenvolvimento da Produção do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, de acordo com os artigos 8º e 9º da Portaria Interministerial MDIC/MCT nº 170, de 4 de agosto de 2010, torna pública a proposta de alteração de Processo Produtivo Básico - PPB.

Manifestações podem ser encaminhadas no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data de publicação desta Consulta no Diário Oficial da União, ao e-mail: cgel.ppb@mdic.gov.br.

HELOÍSA REGINA GUIMARÃES MENEZES

ANEXO

PROPOSTA Nº 068/11 - ALTERAÇÃO DE PROCESSO PRODUTIVO BÁSICO ESTABELECIDO PELAS PORTARIAS INTERMINISTERIAIS Nº 201 E 202, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2007, PARA OS PRODUTOS COMPONENTES SEMICONDUTORES, DISPOSITIVOS OPTOELETRÔNICOS, COMPONENTES A FILME ESPESSO OU A FILME FINO, CÉLULAS FOTOVOLTAICAS e MÓDULOS DE MEMÓRIA VOLÁTIL PADRONIZADOS:

OBS : A Proposta está em formato de minuta de Portaria (Versão Lei de Informática).

Art. 1º Os Processos Produtivos Básicos para os produtos COMPONENTES SEMICONDUTORES, DISPOSITIVOS OPTOELETRÔNICOS, COMPONENTES A FILME ESPESSO OU A FILME FINO, CÉLULAS FOTOVOLTAICAS e MÓDULOS DE MEMÓRIA VOLÁTIL PADRONIZADOS, estabelecidos pela Portaria Interministerial MCT/MICT nº 201, de 13 de novembro de 2007, passam a ser conforme os artigos seguintes.

Art. 2º COMPONENTES SEMICONDUTORES e DISPOSITIVOS OPTOELETRÔNICOS:

- I - corte da lâmina (wafer);
- II - montagem e fixação da pastilha não encapsulada (die);
- III - soldagem dos fios;
- IV - moldagem ou encapsulamento da pastilha montada;
- V - corte ou fixação de esferas para componentes com encapsulamento BGA (Ball Grid Array) ou FBGA (Fine Ball Grid Array), quando aplicável;
- VI - estanhagem e dobra para componentes com encapsulamento TSOP (Thin Small-Outline Packages) ou similar, quando aplicável;
- VII - corte ou singularização, quando aplicável;
- VIII - teste (ensaio) elétrico ou optoeletrônico; e
- IX - marcação (identificação).

§ 1º Os circuitos integrados bipolares com tecnologia maior que cinco micrômetros (micra) e os diodos de potência deverão também realizar o processamento físico-químico da pastilha semicondutora no País.

§ 2º Os circuitos integrados projetados no País, nos termos da Portaria MCT no 950, de 12 de dezembro de 2006, ficam dispensados de realizar a etapa constante do inciso I do caput.

§ 3º As etapas descritas no caput aplicam-se aos dispositivos semicondutores das posições 85.41 e 85.42 da NCM, que utilizem a tecnologia de montagem mediante o processo chip on board diretamente sob placa de circuito impresso, com exceção das etapas IV, V e VI.

Art. 3º COMPONENTES A FILME ESPESSE OU A FILME FINO:

- I - processamento físico-químico sobre o substrato;
- II - montagem dos componentes sobre o substrato, quando aplicável;
- III - teste (ensaio) elétrico ou optoeletrônico; e
- IV - marcação (identificação).

Parágrafo único. Para a produção de circuitos integrados híbridos, ficam dispensados de atender ao disposto no caput do art. 2º desta Portaria os componentes semicondutores utilizados como insumos na produção dos mesmos.

Art. 4º CÉLULAS FOTOVOLTAICAS:

- I - processamento físico-químico referente às etapas de difusão, texturização e metalização;
- II - corte da lâmina; e
- III - teste (ensaio).

Art. 5º MÓDULOS DE MEMÓRIA VOLÁTIL, PADRONIZADOS:

- I - corte da lâmina (wafer);
- II - montagem e fixação da pastilha não encapsulada (die);
- III - soldagem dos fios;
- IV - moldagem ou encapsulamento da pastilha montada;
- V - corte ou fixação de esferas para componentes com encapsulamento BGA (Ball Grid Array) ou FBGA (Fine Ball Grid Array), quando aplicável;
- VI - estanhagem e dobra para componentes com encapsulamento TSOP (Thin Small-Outline Packages) ou similar, quando aplicável;
- VII - corte ou singularização, quando aplicável;
- VIII - teste (ensaio) elétrico ou optoeletrônico;
- IX - marcação (identificação);
- X - montagem e soldagem dos componentes na placa de circuito impresso;
- XI - gravação da memória do tipo Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory - EEPROM ou do circuito integrado controlador; e

XII - testes elétricos, funcionais e etiquetagem para identificação dos módulos, quando aplicável.

§ 1º As etapas constantes dos incisos de I a X deste artigo poderão ser dispensadas em, até, 2% (dois por cento) do total de MÓDULOS DE MEMÓRIA VOLÁTIL, PADRONIZADOS produzidos, no ano-calendário.

§ 2º Poderão ser utilizados circuitos integrados monolíticos do tipo memória de acesso aleatório (Random Access Memory - RAM) importados num percentual máximo de, até, 20% (vinte por cento) na montagem local dos MÓDULOS DE MEMÓRIA VOLÁTIL, PADRONIZADOS produzidos, no ano-calendário.

§ 3º Adicionalmente ao § 2º, no mínimo, 80% (oitenta por cento) dos circuitos integrados do tipo memória importados utilizados na montagem dos MÓDULOS DE MEMÓRIA VOLÁTIL, PADRONIZADO deverão ser marcados e testados no Brasil.

§ 4º A obrigatoriedade estabelecida no § 3º poderá ser dispensada caso a empresa fabricante opte por utilizar circuitos impressos produzidos conforme seu respectivo Processo Produtivo Básico num percentual mínimo de 30% (trinta por cento) de todas as placas de circuitos impressos utilizadas na produção de MÓDULOS DE MEMÓRIA VOLÁTIL, PADRONIZADO, no ano-calendário.

Art. 6º As atividades ou operações inerentes às etapas de produção para cada produto referido no caput do art. 1º desta Portaria poderão ser realizadas por terceiros, desde que obedecido o Processo Produtivo Básico, exceto uma, que não poderá ser objeto de terceirização.

Art. 7º Anualmente, as empresas fabricantes deverão encaminhar às Secretarias de Política de Informática - SEPIN, do Ministério da Ciência e Tecnologia e Secretaria do Desenvolvimento da Produção - SDP, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, até 31 de março do ano posterior, relatório contendo informações referentes à utilização dos percentuais de circuitos integrados do tipo memória e de módulos de memória montados, importados, previstos nestes artigos desta Portaria.

Parágrafo único. O não envio das informações acima citadas por parte da empresa, bem como o não cumprimento dos percentuais estabelecidos nesta Portaria caracterizará o não cumprimento do Processo Produtivo Básico, ficando a empresa sujeita às penalidades previstas no art. 9º da Lei no 8.248, de 1991, e no art. 36 do Decreto no 5.906, de 26 de setembro de 2006.

Art. 8º Sempre que fatores técnicos ou econômicos, devidamente comprovados, assim o determinarem, a realização de qualquer etapa dos Processos Produtivos Básicos poderá ser suspensa temporariamente ou modificada, por meio de Portaria conjunta dos Ministros de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e da Ciência, Tecnologia e Inovação.

Art. 9º Fica revogada a Portaria Interministerial MCT/MICT Nº 201, de 13 de novembro de 2007.

Art. 10. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.